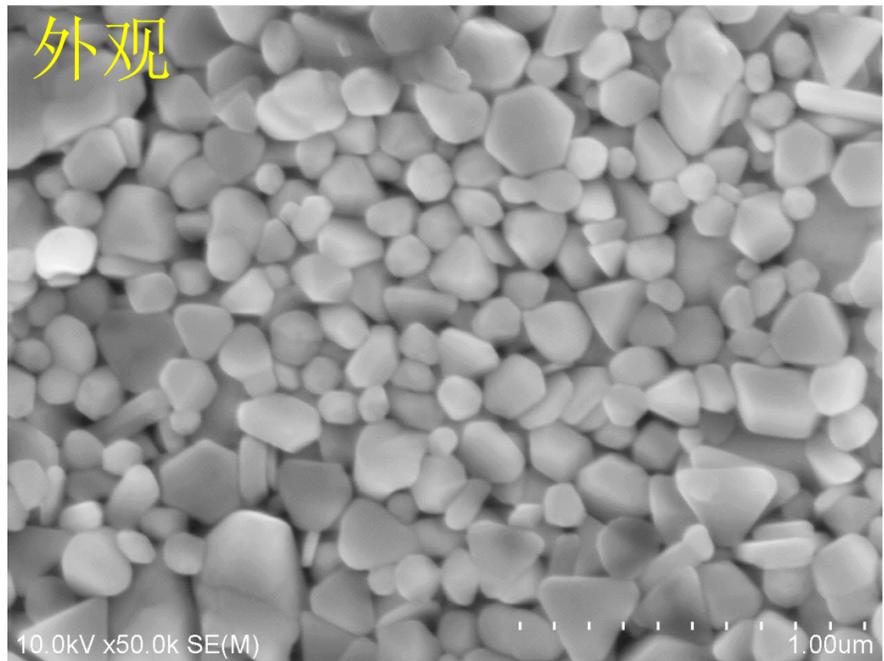


可用于导电性粘合材料

KM120(低温烧结银)



外观



产品名称	D50 (μm)	T.D (g/ml)	BET (m ² /g)	烧结温度 (°C)
KM120	0.15~0.30	3.0~4.5 (参考值)	1.5~2.5 (参考值)	120

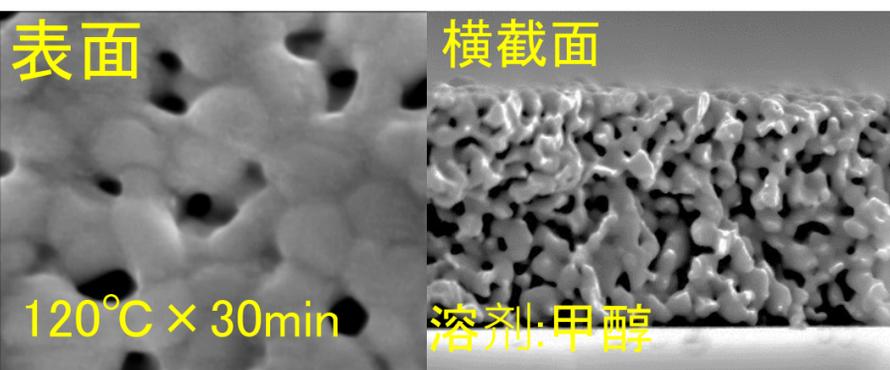
KM120通过优化多面体的尺寸实现了120° C的低温烧结。

满足低温范围内所需的特性，到现在为止，布线，粘合剂和散热材料都很难实现。

1. 低温领域的电气特性

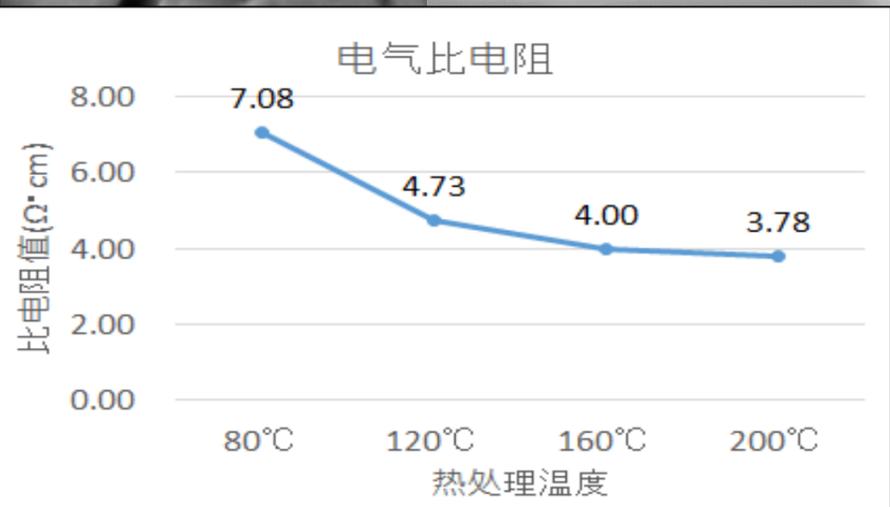
表面

横截面



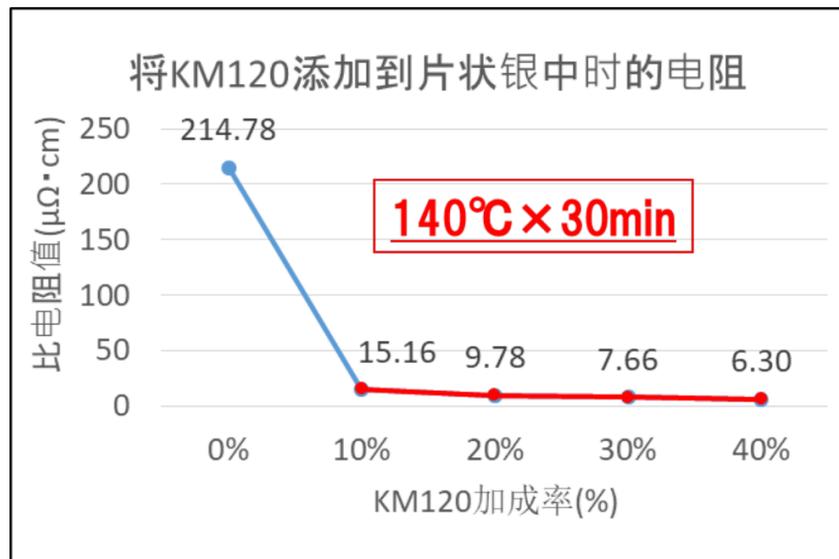
120°C × 30min

溶剂: 甲醇



✓在低温范围内表现出等效体积的电性能

2. 用作添加剂银



✓即使用作添加剂银，也可显著提 高导电性

3. 其他

✓浓度 ≥ 90% 可以在提供

✓可以溶解在客户指定的溶剂中



【联系我们】

业务发展部

市场营销(负责:井町)

TEL:0794-63-9003

MAIL:imachi-shinichi@tokusen.co.jp